

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号
特表2003-533009
(P2003-533009A)

(43) 公表日 平成15年11月5日 (2003.11.5)

(51) Int.Cl. ¹	識別記号	F I	テームコード (参考)
H 0 1 S 5/022		H 0 1 S 5/022	2 H 0 3 7
G 0 2 B 6/42		G 0 2 B 6/42	5 F 0 7 3

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 24 頁)

(21) 出願番号 特願2001-520536(P2001-520536)
(86) (22) 出願日 平成12年9月1日 (2000.9.1)
(85) 翻訳文提出日 平成14年3月4日 (2002.3.4)
(86) 国際出願番号 P C T / U S 0 0 / 2 4 0 2 3
(87) 国際公開番号 W O 0 1 / 0 1 6 6 3 4
(87) 国際公開日 平成13年3月8日 (2001.3.8)
(31) 優先権主張番号 0 9 / 3 8 9 , 8 6 4
(32) 優先日 平成11年9月2日 (1999.9.2)
(33) 優先権主張国 米国 (U S)

(71) 出願人 インテル・コーポレーション
アメリカ合衆国 95052 カリフォルニア
州・サンタクララ・ミッション カレッジ
ブーレバード・2200

(72) 発明者 ヴァーディール, ジャン・マルク
アメリカ合衆国・94306・カリフォルニア
州・パロ アルト・エル カミノ ウェ
イ・4159ビイ

(74) 代理人 弁理士 山川 政樹

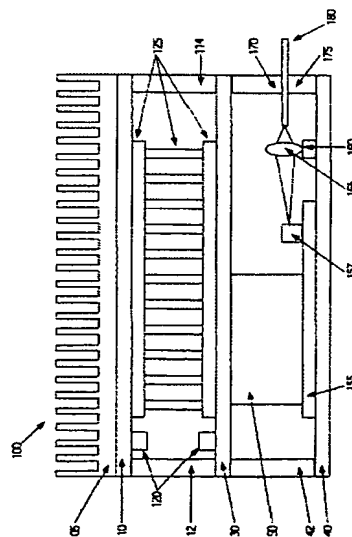
Fターム (参考) 2H037 AA01 BA03 BA32 CA13 DA03
DA04 DA05 DA36 DA38
5F073 AB27 AB28 BA02 FA22 FA25
FA29

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 2重格納部光電子パッケージ

(57) 【要約】

本発明は、光学部品と電子部品を別々の格納部に収容するパッケージ (100) である。第1格納部 (142/130/170/175) は、光学部品 (165/157/180)、光学アライメント手段 (160) および内部の光学部品により生成された熱を消散させる熱パイプ (155) を含む。第1および第2格納部は、ハーメチックシールされている。第2格納部 (130/112/110/114) は、電子部品 (120)、ペルティエ型冷却デバイス (125)、および/または、他の熱消散デバイスを含む。第1および第2格納部は、それぞれ、ハーメチックシールされている。第1格納部は、第2格納部の上に搭載されるか、または、本発明の別の実施形態では、その逆に搭載されることができる。別の実施形態において、ヒートシンク (105) は、また、2重格納部パッケージの上部に搭載される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも1つの光学部品と少なくとも1つの光学部品から熱を逃がすための熱パイプを有する第1格納部と、

第1格納部に熱的に結合され、第1格納部の熱を制御するための少なくとも1つの熱制御デバイスを有する第2格納部とを有する光電子パッケージ。

【請求項2】 熱制御デバイスが、第1格納部から熱を消散させるための熱消散デバイスを有する請求項1に記載の光電子パッケージ。

【請求項3】 熱制御デバイスが、第1格納部へ熱を提供するための熱デバイスを有する請求項1に記載の光電子パッケージ。

【請求項4】 熱制御デバイスが、第1格納部の中で熱を安定化させるための熱安定化デバイスを有する請求項1に記載の光電子パッケージ。

【請求項5】 第1および第2が気密性の格納部である請求項1に記載のパッケージ。

【請求項6】 第1格納部が有機物を含まない請求項1に記載の光電子パッケージ。

【請求項7】 第1格納部がフラックス残留物を有しない請求項1に記載の光電子パッケージ。

【請求項8】 第1格納部が第2格納部の上に配置される請求項1に記載の光電子パッケージ。

【請求項9】 第2格納部が第1格納部の上に配置される請求項1に記載の光電子パッケージ。

【請求項10】 さらに、第2格納部に熱的に結合されたヒートシンクを備える請求項1に記載の光電子パッケージ。

【請求項11】 第1および第2格納部が、熱が消散される共通の構造を通して取り付けられる請求項1に記載の光電子パッケージ。

【請求項12】 共通の構造が第1および第2格納部の間で共有された壁を備える請求項11に記載の光電子パッケージ。

【請求項13】 共通の構造が基板を備える請求項11に記載の光電子パッケージ。

【請求項14】 基板が1つまたは複数の電気接続用の1つまたは複数の開口部を含む請求項13に記載の光電子パッケージ。

【請求項15】 1つまたは複数の開口部が1つまたは複数の気密性のビアを備える請求項14に記載の光電子パッケージ。

【請求項16】 基板が第1および第2格納部の間で気密性の壁を形成する請求項13に記載の光電子パッケージ。

【請求項17】 熱消散デバイスがペルティエ冷却デバイスを備える請求項1に記載の光電子パッケージ。

【請求項18】 第1格納部の気密性が第2格納部の気密性より高い請求項1に記載の光電子パッケージ。

【請求項19】 さらに、第1および第2格納部の間に、光学部品に対する電気接続を可能にするためのビアを備える請求項1に記載の光電子パッケージ。

【請求項20】 第1格納部が、さらに、光学部品と熱パイプに熱的に結合された熱伝播器を備える請求項1に記載の光電子パッケージ。

【請求項21】 第1格納部が、さらに、少なくとも1つの電気接続が第1格納部の中の光学部品に与えられる、少なくとも1つのビアを有する基板を備える請求項1に記載の光電子パッケージ。

【請求項22】 基板と、
基板上に形成された第1格納部とを備え、その第1格納部は
第1の複数の側壁と、
組み立て品の間中部と、
第1格納部の中に配置された熱伝播器と、
熱伝播器と組み立て品の間中部との間で熱を通すための熱パイプとを有し、さらに

第1格納部の中に配置され、熱伝播器と熱的に結合された光学要素と、
組み立て品の間中部に熱的に結合された第2格納部とを備え、第2格納部が、
光学部品により生成された熱を第1格納部から消散させるための、少なくとも1つの熱消散デバイスを有する、2重格納部光電子パッケージ。

【請求項23】 第1格納部がフラックス残留物を有しない請求項22に記載

載のパッケージ。

【請求項24】 第1格納部が有機物を含まない請求項22に記載のパッケージ。

【請求項25】 少なくとも1つの消散デバイスが熱を第1格納部から第2格納部の天井へ運ぶためのペルティエ冷却デバイスを有する請求項22に記載のパッケージ。

【請求項26】 さらに、第2格納部の天井に熱的に結合されたヒートシンクを備える請求項22に記載のパッケージ。

【請求項27】 基板が第1格納部の外側から第1格納部の内部への電気接続を提供する請求項22に記載のパッケージ。

【請求項28】 複数の側壁が光学部品をおおう気密性のキャップを形成する請求項22に記載のパッケージ。

【請求項29】 第2格納部が気密性のキャップを備える請求項22に記載のパッケージ。

【請求項30】 基板が第1および第2格納部の両方に対して気密性の壁を形成する請求項22に記載のパッケージ。

【請求項31】 基板と、
基板上に結合された第1格納部とを備え、その第1格納部は
第1の複数の側壁と、
組み立て品の間部により形成された天井と、
ペルティエ冷却デバイスとを有し、さらに
組み立て品の間部に結合された第2格納部を備え、その第2格納部は、
第2の複数の側壁と、
組み立て品の間部により形成された天井と、
第2格納部の中に配置された熱伝播器と、熱伝播器と天井の間で熱を運ぶための熱パイプと、
熱伝播器に熱的に結合された光学部品と
を備える、2重格納部光電子パッケージ。

【請求項32】 少なくとも1つの光学部品と電気接続を有する少なくとも

1つの光学部品から熱を逃がすための熱パイプを有する第1格納部と、

第1格納部に熱的に結合され、第1格納部から熱を消散させるための少なくとも1つの消散デバイスを有する第2格納部とを備え、大部分の熱が電気接続と反対の光学部品の側面方向に消散するように、熱消散デバイスが熱を第1格納部から消散させる光電子パッケージ。

【請求項33】 第1格納部がフラックス残留物を有しない請求項25に記載の光電子パッケージ。

【請求項34】 第1格納部が有機物を有しない請求項32に記載の光電子パッケージ。

【請求項35】 さらに、第2格納部に熱的に結合されたヒートシンクを備える請求項32に記載の光電子パッケージ。

【請求項36】 第1および第2格納部が熱が消散される、共通の構造を通して取り付けられる請求項32に記載の光電子パッケージ。

【請求項37】 共通構造が第1および第2格納部の間で共有された壁を備える請求項36に記載の光電子パッケージ。

【請求項38】 共通構造が基板を備える請求項36に記載の光電子パッケージ。

【請求項39】 基板がパッケージからの電気接続の経路を定める請求項36に記載の光電子パッケージ。

【請求項40】 熱消散デバイスがペルティエ冷却デバイスを備える請求項32に記載の光電子パッケージ。

【請求項41】 第1格納部が、さらに、光学部品と熱パイプに熱的に結合された熱伝播器を備える請求項1に記載の光電子パッケージ。

【請求項42】 少なくとも1つの光学部品と少なくとも1つの光学部品から熱を逃がすための熱パイプを有する第1格納部と、

第1格納部に熱的に結合され、第1格納部に関する熱を制御するための少なくとも1つの熱制御デバイスを有する第2格納部とを有する、光電子パッケージ。

【請求項43】 第1格納部の上面に結合された少なくとも1つの光学部品と、少なくとも1つの光学部品から熱を逃がすための熱パイプと、光学部品から

第1格納部の底面に経路を定められた電気接続とを有する第1格納部と、

第1格納部に熱的に結合され、第1格納部から熱を消散させるための少なくとも1つの消散デバイスを有する第2格納部と
を備える光電子パッケージ。

【請求項44】 熱制御デバイスが熱を第1格納部から消散させるための熱消散デバイスを備える請求項43に記載の光電子パッケージ。

【請求項45】 熱制御デバイスが第1格納部を過熱するための過熱デバイスを備える請求項43に記載の光電子パッケージ。

【請求項46】 第2格納部が第1格納部の上に配置される請求項43に記載の光電子パッケージ。

【請求項47】 さらに、第2格納部に熱的に結合されたヒートシンクを備える請求項43に記載の光電子パッケージ。

【請求項48】 第1および第2格納部が熱が消散される、共通の構造を通して取り付けられる請求項43に記載の光電子パッケージ。

【請求項49】 共通の構造が第1および第2格納部の間で共有された壁を備える請求項48に記載の光電子パッケージ。

【請求項50】 熱消散デバイスがペルティエ冷却デバイスを備える請求項43に記載の光電子パッケージ。

【請求項51】 第1格納部の気密性が第2格納部の気密性より高い請求項43に記載の光電子パッケージ。

【請求項52】 さらに、第1および第2格納部の間に、光学部品への電気接続を可能にするビアを備える請求項43に記載の光電子パッケージ。

【請求項53】 第1格納部が、さらに、光学部品と熱パイプに熱的に結合された熱伝播器を備える請求項43に記載の光電子パッケージ。

【請求項54】 第1格納部が、さらに、少なくとも1つの電気接続が第1格納部の光学部品に与えられる、少なくとも1つのビアを有する基板を備える請求項43に記載の光電子パッケージ。

【請求項55】 熱制御デバイスが第1格納部の中で熱を安定化するための熱安定化デバイスを備える請求項43に記載の光電子パッケージ。

【請求項56】 第1および第2が気密性の格納部である請求項43に記載のパッケージ。

【請求項57】 第1格納部が有機物を含まない請求項43に記載の光電子パッケージ。

【請求項58】 第1格納部がフラックス残留物を有しない請求項43に記載の光電子パッケージ。

【請求項59】 少なくとも1つの光学部品と、少なくとも1つの光学部品から熱を逃がすための熱パイプと、

第1格納部に熱的に結合され、また、それを囲み、第1格納部から熱を消散させるための少なくとも1つの消散デバイスを有する第2格納部とを備える、光電子パッケージ。

【発明の詳細な説明】**【0001】****(発明の分野)**

本発明は、光学部品や電子部品双方のパッケージに関する。より詳細には、本発明は、光学部品と電子部品を収容する2重の格納部を備えたパッケージに関する。

【0002】**(発明の背景)**

光学部品は電子部品とますます一体化されるようになったため、光電子デバイス用パッケージが開発された。光学部品パッケージと電子部品パッケージは、別々に、異なるパッケージングの問題を解決するために設計されてきた。たとえば、光学部品は、注意深く位置合わせされなければならないし、また、位置合わせは、適切な機能のために維持されなければならない。

【0003】

光電子パッケージングは、通常、いくつかの制約を守らなければならない。一制約は、パッケージ内で生成された任意の熱は除去されなければならない、パッケージへのそれぞれの干渉を含めて、パッケージ内で電子回路と光学部品とが干渉してはならないことである。従来技術において、熱パスは、通常、電気パスと干渉する。たとえば、標準のバタフライ・パッケージにおいて、熱が生成され、パッケージの底の方に拡散するが、電気接続はパッケージの側面に沿って中間の高さである。これは、標準のプリント回路板の搭載には非実用的である。光電子パッケージに関する別の制約は、ほとんどのWDM光電子回路が温度制御（たとえば、レーザ送信の波長制御、ポンプの熱消散）を必要とすることである。必要な温度制御なしでは、レーザ送信の波長制御において問題が生ずるかもしれない。同様に、温度制御なしでは、たとえば、ポンプ・レーザからの適当な熱消散が問題を引き起こす可能性がある。3番目に、光電子パッケージに関する別の制約は、特にレーザ・ダイオードのような能動光電子チップは、低いガス放出（outgassing）の密封封入を必要とすることである。すなわち、その封入における全体組み立て品は、接着剤を有することができず、フラックスを用いないで、

はんだ付けが行われなければならない。これを行うことは、製造の観点から極端に難しい。

【0004】

光電子パッケージに関する多くの制約のために、現在の光電子パッケージは、大きく、高価で、製造が難しい。改善された光電子パッケージが必要とされている。

【0005】

(発明の概要)

2重格納部光電子パッケージが説明されている。パッケージは、少なくとも1つの光学部品と熱を光学部品から逃がす熱パイプを有する第1格納部および第1格納部と熱的に結合され、熱を第1格納部から消散させる少なくとも1つの熱消散デバイスを有する第2格納部を含む。

【0006】

本発明は、限定的なものではなく、例示的なものとして、添付図において説明されており、図中で同じ参照数字は同じ要素を指す。

【0007】

(詳細な説明)

2重格納部光電子パッケージが説明されている。以下の説明において、説明を目的として、本発明を完全に理解するために、多くの特定の詳細が述べられている。しかし、本発明がこれら特定の詳細なしで行われることができることは、当業者にとって明かになるであろう。他の例において、構造およびデバイスは、本発明をあいまいにすることを避けるために、ブロック図の形で示されている。

【0008】

本明細書において「一実施形態」、または「ある実施形態」を参照することは、その実施形態に関連して述べられている特定の機能、構造または特徴が少なくとも本発明の一実施形態に含まれていることを意味している。本明細書の中の種々の場所において「一実施形態において」という言葉が現れた時、それは必ずしも全てが同じ実施形態を指しているわけでもない。

【0009】

(概観)

2重格納部を用いて、光電子部品および／または光学部品（たとえば、レーザ・ダイオード、レンズ、ファイバなど）を収容するパッケージが説明されている。第1格納部は、高信頼性の光電子組み立て品を創造するのに必要なアライメント、気密性および低ガス放出を持つ光部品を含む。第1格納部は、また、中の部品により生成された熱を消散させ、別の格納部にその熱を運ぶための熱パイプまたは他の熱消散デバイスを含む。第2格納部は、1つまたは複数の別の熱消散デバイス（たとえば、ペルティエ冷却デバイス）を含む。第2格納部は、熱的および機械的に第1格納部と結合されている。一実施形態において、第2格納部は、第1格納部の上に、または、その逆に位置する。

【0010】

第2格納部は光学部品を含まないため、ガス放出材料が組み立て品に対して使用されてもよい。換言すれば、フラックスなしで、有機物なしの組み立て品材料の使用は、重要な光学要素（たとえば、レーザ・ダイオードおよび結合光学部品）のみを含む1つの格納部であるか、または、それに限定させることができ、一方、冷却（およびしばしば電子部品）は、接着剤またはフラックスによる標準のはんだ付けを用いた第2格納部に搭載させることができ、その方法が製造の観点からずっと容易である。第2格納部は感光性要素を含まないため、第2格納部の気密性の必要条件は第1格納部の必要条件と異なるかもしれない。

【0011】

ヒートシンクまたは他の熱消散デバイスは、2重格納部組み立て品に結合される。一実施形態において、ヒートシンクは、第1格納部により生成され、第2格納部へ伝達された熱を消散させるために、第2格納部に結合される。

【0012】

ある実施形態において、2重格納部組み立て品は、低価格で大量生産されるが、光格納部の中の、光ファイバまたは内部の部分を含む光学部品の精密アライメントを維持する。

【0013】

図1は、光電子パッケージの一実施形態の側面断面図である。図1を参照する

と、組み立て品100は、下部格納部の中に1つまたは複数の熱消散デバイスと上部格納部の中に少なくとも1つの熱消散デバイスを持つ、2重格納部光電子パッケージ・ハウジング光学部品である。

【0014】

光電子パッケージ100は光学格納部に対する床となっている基板140の上に作られる。一実施形態において、基板140は、非常に低い膨張材料（たとえば、アルミナ・セラミック）であり、良好な機械的安定性を有する。光ファイバ180は、パッケージ100の下部格納部の中の部品と（図1には示されない）外部デバイスとの間で光信号を伝達する。一実施形態において、光ファイバ180は、側壁170と175の間に形成された開口部を通る。別法として、単一の壁に管または穴を設けても良い。光ファイバ180が通る開口部は、所望の気密性を持つように、当分野で公知の任意の方法でシールされる。光ファイバの代わりに、壁の内部でシールされた窓またはレンズ、または、気密性の光学コネクタ・ハウジングのような、他の気密性の光インタフェースを使用することができる。光学格納部はまた側壁142を含む。

【0015】

一実施形態において、下部格納部の中で、熱伝播部155が基板140の上にある。熱伝播部155は部品157（たとえば、レーザ・ダイオード）を支持し、熱を大きな面積にわたって部品157から分散させる。さらに、熱伝播部155は、部品157を光学的に位置合わせするために高さ調整を備えていても良いし、また、部品157が能動光電子要素（たとえば、レーザ・ダイオード）である時、部品157に対する電気接点を設けてもよい。熱パイプ150が、熱伝播部155の上にあるか、または、熱的および機械的にそれに結合されており、熱伝播部155から下部格納部の天井であり、かつ上部格納部の床として機能する組み立て品の間中部に熱を運ぶ。

【0016】

一実施形態において、支持部160が基板140の上にある。支持部160は、光学データがデバイス157から光ファイバ180に伝達されるように、部品160（たとえば、レンズ）に対して適切なアライメントを提供する。図1の実

施形態は、2つの光学部品（すなわち、157と165）を含むが、任意の数の光学部品が光学格納部の中に含まれる。

【0017】

一実施形態において、熱伝播部155および／または支持部160は、たとえば、タンゲステン銅、窒化アルミニウム、酸化ベリリウムまたは窒化ボロンのような高熱伝導材料で作られたサブマウントである。熱伝播部155および／または支持部160は、たとえば、はんだ付け、または、ろう付けにより取り付けられることができ、または、基板材料自体の一部であってもよい。

【0018】

一実施形態において、部品157は、熱伝播部155および／または支持部160上に搭載された、たとえば、レーザダイオード、変調器、検出器のような、端部発光側部搭載のデバイスまたは、導波管デバイスを備えてもよい。たとえば、マイクロ・レンズ、フィルタ、スプリッタ、絶縁体のようなマイクロ光学要素は、基板140および／または支持部160の上に直接に搭載されてもよい。

【0019】

一実施形態において、熱伝播部155および／または支持部160の高さおよび光学部品の高さは、光学部品157や165が垂直に並ぶ（すなわち、これらの光学軸が第1格納部の床に平行な共通平面の中にある）ように選択される。

【0020】

一実施形態において、熱伝播部155および／または支持部160の高さは、基板140の長さの何分の1（たとえば、 $< 1/10$ ）かであるため、組み立て品は本質上2次元で、ピック・アンド・プレイス自動化を用いて製造することができる。高精度の自動化されたピック・アンド・プレイス組み立てを用いると、光学部品間の光学的関係が、縦横の次元において、数 μm の精度以内で設定できる。部品間の高さのアライメントは熱伝播部155および／または支持部160の高さにより設定される。材料の精密な制御または研磨技術を用いて、熱伝播部155および／または支持部160の高さを、数 μm またはそれを下回る値の範囲内に制御することができる。

【0021】

一実施形態において、内部部品から下部格納部の外側のピンに対する電気信号の分配は、基板140の底を通してビアのセットにより行われる。一実施形態において、ビアは、気密充填されたビアを備える。別の実施形態において、電気接続は、基板140の上部と低部に、パターンのセットとして、直接印刷されたラインのセットにより提供される。上部と低部の導電パターンは、ビアにより電気接続される。パッケージの上部を通しての熱消散を有することおよびパッケージの底を通しての電気接続を有することにより、電気パスおよび熱パスは、実質上互いに干渉しない。そのため、パッケージは、プリント回路板（PCB）上に任意の他の電子部品と同様に搭載されてもよい。また、このことにより、PCBに対する電気接続をずっと短くすることができるため、より良い高速性能を提供することができる。ビアを用いると、パッケージの下に任意の別の配線またはスルーウォール（through-wall）気密フィードスルー（feedthrough）なしで、パッケージの周辺のピン、ボール・グリッド・アレイまたは同様な構造に対して、下部格納部からの信号が分配できる。ビアが短く（たとえば、約1mmを下回る）、線材長さが減ぜられるため、そうでなければ動作速度を制限するであろう、寄生静電容量およびインダクタンスを減少させることができる。その構成は高速接続に対して有利である。たとえば、部品157がレーザ・ダイオードを備える時、基板140を通したその接続は、非常に短い、高速接続（たとえば、1～2mm）とすることができる。

【0022】

基板140、側壁142、170、175および組み立て品の間中部130は、光学部品に対して適切な気密性を提供する、当分野において公知の任意の方法で組み立てられる。一実施形態において、下部格納部は、高い気密性を有し、ガス放出を制御するために、有機物なしで、フラックスなしである。一実施形態において、下部格納部の漏れ率は、 10^{-8} atm/cc・sに等しいか、または、それを下回る。一実施形態において、側壁142、170と175および間中部130は、基板140をおおうキャップとして機能する単一材料を備える。一実施形態において、間中部130はセラミック基板を備える。

【0023】

上部格納部は次に組み立てられ、冷却および電子部品に対する適切な気密性を提供する。上部格納部は、接着剤（たとえば、エポキシ樹脂）、フラックスなどで組み立てられる。一実施形態において、上部格納部の気密性は低く、また、下部格納部の気密性より低い。一実施形態において、上部格納部の漏れ率は、 10^{-5} atm/cc.sに等しいか、または、それを下回る。別法として、上部格納部が最初に組み立てられ、次に、光学格納部が組み立てられることができる。

【0024】

一実施形態において、上部格納部は、組み立て品の間中部130、壁112と114および天井110を含む。上部格納部は、内部の部品に対して適切な気密性を提供する。一実施形態において、上部格納部は、ペルティエ冷却器125および、たとえば、サーミスタ、集積回路、温度制御回路、信号処理デバイス、マルチプレクサ、レーザ・ダイオード・ドライバ、マイクロ制御器などのような電子部品120を含む。ペルティエ冷却器125は、本発明を実施するのに必ず必要というわけではない、ペルティエ冷却器125は、ペルティエ冷却デバイスなしの実施形態よりもよい温度制御または熱消散を提供する。別の実施形態において、他の型の電子熱消散デバイスが使用されてもよい。また、別の実施形態において、上部格納部は、ペルチエ冷却器125または他の熱消散デバイスを含んでもよいし、また、電子部品120を含まなくてもよい。

【0025】

熱消散デバイスの代わりに、上部格納部は、下部格納部の熱を安定化するのを助けるための、熱を生成する過熱要素または熱安定化要素のような熱制御デバイスを含んでもよい。

【0026】

ヒートシンク105は、当分野において公知の任意の方法で天井110に取りつけられる。ヒートシンク105は、ひれ型ヒートシンクとして説明されているが、任意の型のヒートシンクが使用されてもよい。

【0027】

それぞれの格納部の部品の間の接続を提供するために、（図1に示されていない）1つまたは複数の開口部が上部および下部格納部の間に提供されてもよい。

一実施形態において、格納部の間の開口部は、それぞれの格納部の気密性の環境が保存されるようにシールされる。

【0028】

図2は、光電子パッケージの一実施形態の側面図である。組み立て品200は、光学部品が下部格納部の代わりに上部格納部の中にあり、下部格納部が熱消散デバイスを含むこと除いて、図1で説明したパッケージと同じ2重格納部光電子パッケージである。2つの格納部は基板を用いて結合される。

【0029】

図2を参照すると、一実施形態において、光電子および／または光学部品は、図1と同様に、上部格納部に含まれる。たとえば、上部格納部の中で、熱伝播器250および支持部260は、組み立て品の間中部240の上にある。熱伝播器250は、光学部品255（たとえば、レーザ・ダイオード）から熱を消散および分散させるように動作する。支持部260は、光学部品265（たとえば、レンズ）を光ファイバ280および光学部品255と光学的に位置合わせするように動作する。適切なアライメントを提供するために、全ての光学部品が支持部260を必要とするわけでない。別の実施形態において、異なる数の光学部品が光学格納部に含まれる。

【0030】

上部格納部は、組み立て品の間中部240、側壁242、270と275および天井230を含む。一実施形態において、側壁270と275は、光ファイバ280に対する開口部を提供するが、2つの部分側壁よりも単一側壁が使用される可能性がある。光ファイバ280に対して提供された開口は、上部格納部に対して適切な気密性を保つためにシールされる。

【0031】

図2の間中部240は、2つの格納部の間の中間部として機能するのと同様に、電気信号を上部格納部の部品に伝達するための基板としても機能する。したがって、内部部品から上部格納部の外側のピンへの電気信号の分配は、図1に関連して上述されたように、間中部240の底を通して、ビアのセットにより行われる。一実施形態において、ビアは、気密充填ビアを備える。別の実施形態におい

て、電気接続は、パターンのセットとして、中間部240の上部および低部上に直接に印刷されたラインのセットにより提供される。上部および低部の導電パターンは、ビアにより電気接続される。ビアを用いると、上部格納部からの信号は、パッケージの周辺のピンまたは下部格納部に配置された電子部品220に分配されてもよい。

【0032】

下部格納部は、基板210、側壁212と214および組み立て品の中間部240を含む。一実施形態において、ペルティエ冷却器225および電子部品220は、下部格納部の中に配置されるが、上述したように、ペルティエ冷却器225は、本発明を実施するのに必ず必要なわけではない。ペルティエ冷却器225は、上部格納部の光学部品により生成された熱を組み立て品の中間部240から運ぶことができる。一実施形態において、ペルティエ冷却器225は、接着剤または任意の他のよく知られた接着機構（たとえば、はんだ）を用いて、下部格納部の上部および低部に取り付けられる。

【0033】

一実施形態において、組み立て品の中間部240は、デバイスの周辺で電気接続用支持部を提供するために、側壁212および214を超えて延びる。ヒートシンクまたは他の熱消散デバイスは、さらなる熱消散能力を提供するために、下部格納部か、または、組み立て品の中間部240に取りつけられてもよい。別の実施形態において、組み立て品の中間部240は、底210と同じ幅を有する。

【0034】

中間部240、側壁212と214および底210は、熱消散部品に対して適切な気密性を提供するために、当分野において公知の任意の方法で組み立てられる。一実施形態において、側壁212と214および底210は、中間部240をおおう単一の材料で構成される。

【0035】

一実施形態において、中間部240は、セラミック基板で構成される。組み立て品の中間部240は、格納部の中の部品の間で1つまたは複数の接続を可能にするために、（図2では示されない）1つまたは複数の開口部を含んでもよい。

開口部は、下部格納部および上部格納部に対して所望の気密性を提供するためにシールされる。

【0036】

図3は、図2に示された2重格納部組み立て品の別の実施形態である。図3を参照すると、光学部品を含む格納部は、完全にパッケージの中にあり、本質的に、1つまたは複数の熱消散デバイスを含む格納部の中にある。この実施形態は、信頼性を増し、格納部内部の正確な温度制御を容易にする、光学部品からパッケージの外部への2重の保護壁を提供する。

【0037】

図4は、パッケージの別の実施形態を説明する。図4を参照すると、パッケージは、下部格納部の中の光電子および光学部品が下部格納部の下側ではなくて上側に取り付けられていることを除いて、図1に示されたパッケージと同じである。一実施形態において、この場合、下部格納部の上側部分からパッケージが搭載される板への接続により、パッケージ内で高速デバイスを使用できるように、下部格納部が十分に低い高さを有する。たとえば、格納部の高さ（厚み）は数mmに限定される。

【0038】

プラットフォーム上に1つまたは複数の要素を有する、光電子パッケージの実施形態が本明細書で説明されたが、これらの要素をパッケージの床に配置する一方で、パッケージの床の上面の下にパッケージの他の光学要素を搭載することは、本発明の教授の範囲内である。

【0039】

上述の仕様において、本発明は、特定の実施形態を参照して説明された。しかし、本発明の広い意味での精神および範囲から逸脱することなく、種々の修正および変更が行われることができることが明かになるであろう。仕様および図は、したがって、制限的な意味ではなくて説明的な意味で考えられるべきである。

【図面の簡単な説明】

【図1】

光電子パッケージの一実施形態の側面断面図である。

【図2】

光電子パッケージの別の実施形態の側面断面図である。

【図3】

光電子パッケージの別の実施形態の側面断面図である。

【図4】

光電子パッケージの別の実施形態の側面断面図である。

【図1】

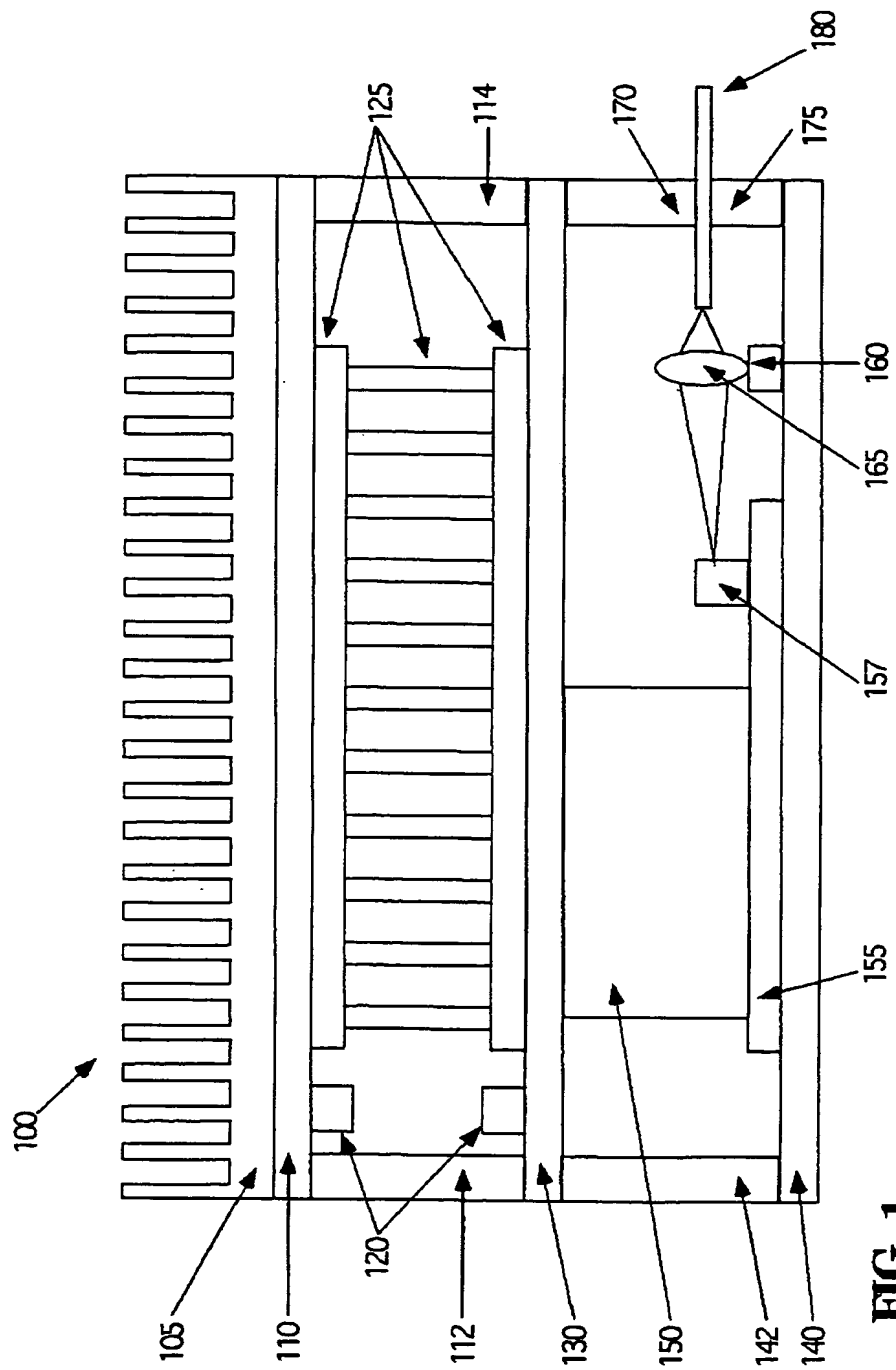


FIG. 1

【図2】

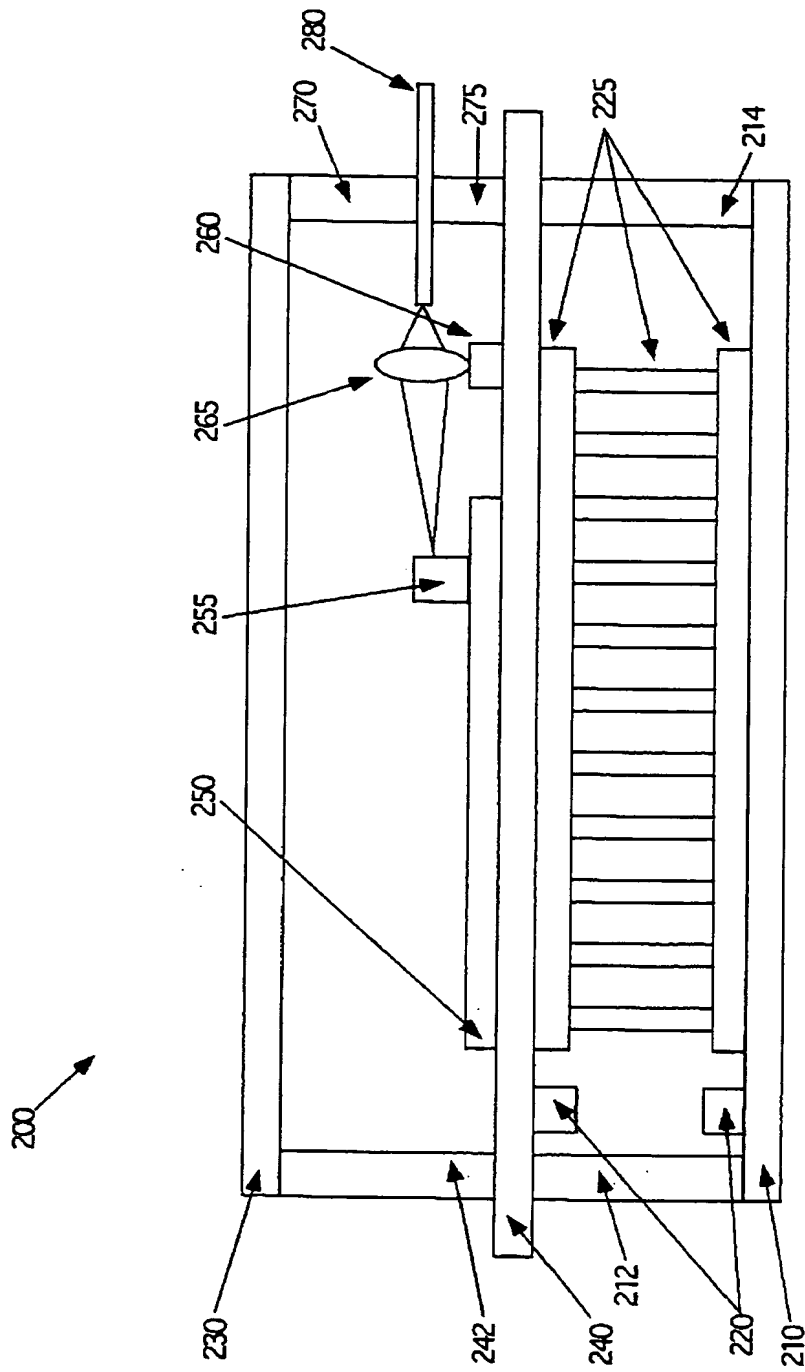


FIG. 2

(21)

特表2003-533009

【図3】

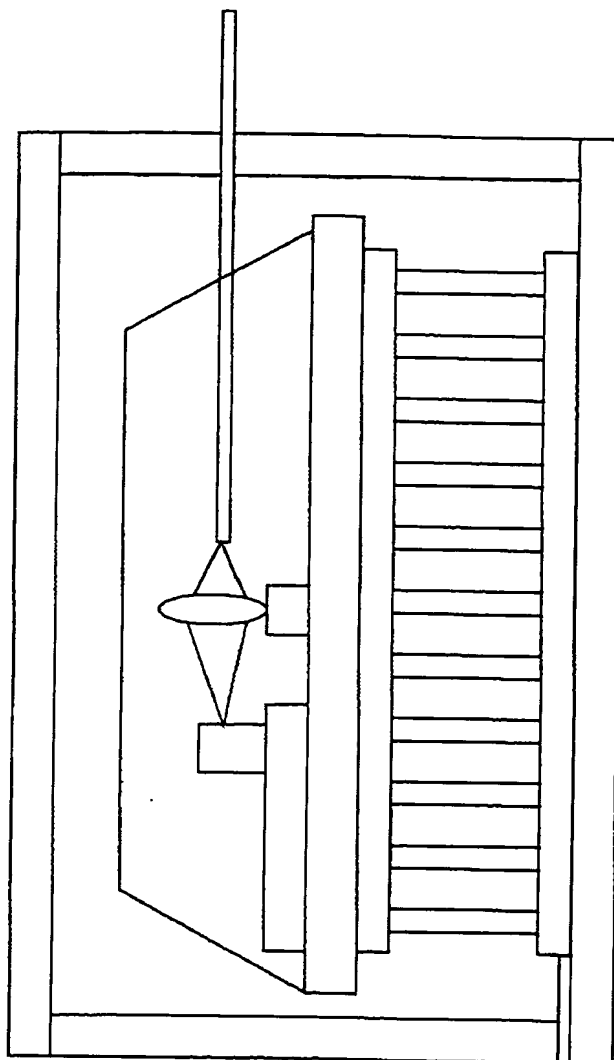


FIG. 3

【図4】

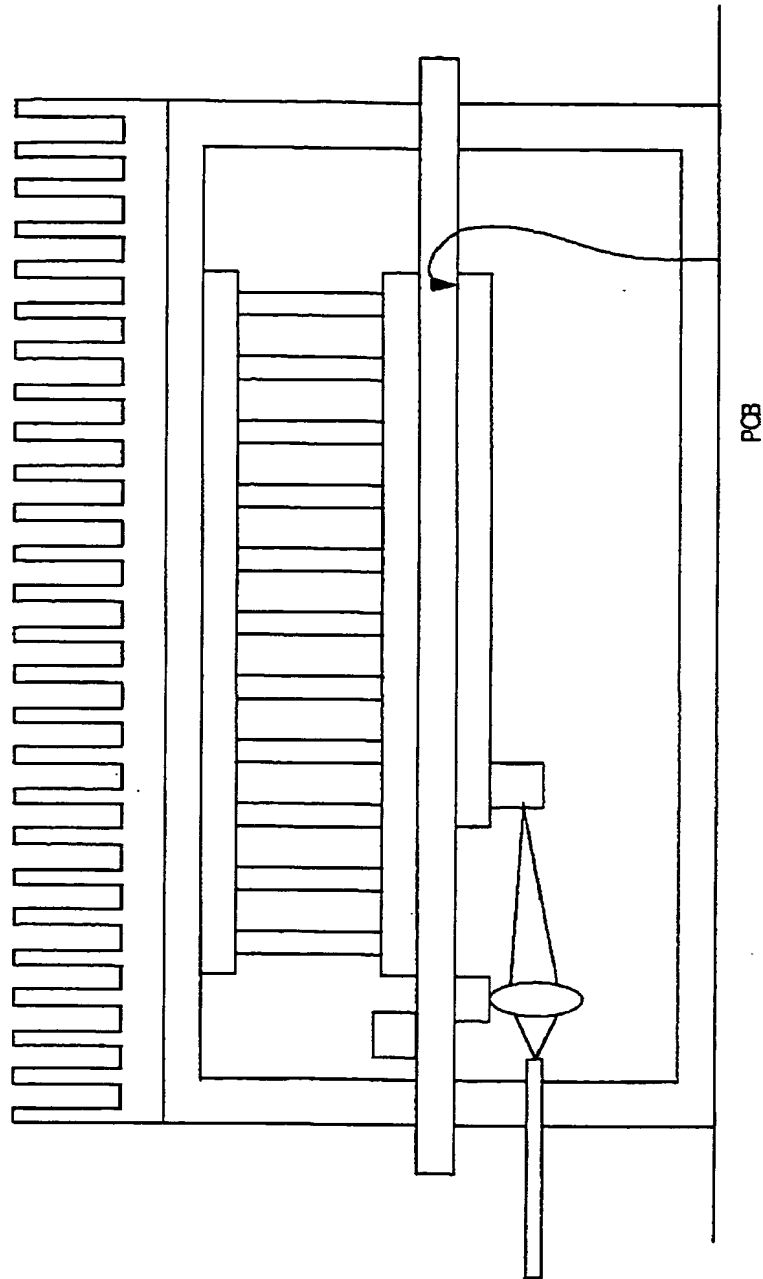


FIG.4

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/US00/24023
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC(7) : G02B 6/36, 7/00; H01S 3/04 US CL : 359/820; 372/34, 36; 385/92, 94 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) U.S. : 359/820; 372/34, 36; 385/88, 92, 94, 137 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) USPAT; EPO; JPO		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X, P	US 6,027,256A (NIGHTINGALE et al.) 22 February 2000 (22.02.2000), entire document, especially: column 1, lines 47-56; column 3, lines 10-18; column 4, lines 11-33 and 61-62; column 5, lines 18-30 and 60-64; column 6, lines 1-36; and column 8, lines 23-25	1-21, 32, 34-42, 59
A	US 5,930,430A (PAN et al.), 27 July 1999 (27.07.1999), entire document.	1-59
A	US 5,011,256A (JOHNSON et al.) 30 April 1991 (30.04.1991), entire document.	1-59
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "B" earlier application or patent published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later documents published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principles or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, each contribution being obvious to a person skilled in the art "Z" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report 06 DEC 2000
Name and mailing address of the ISA/US Commissioner of Patents and Trademarks Box PCT Washington, D.C. 20231 Facsimile No. (703)305-3230		Authorized officer: Georgia Y Epps Telephone No. 703-308-4883

フロントページの続き

(81)指定国 EP(AT, BE, CH, CY,
DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I
T, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ
, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, K
E, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG
, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD,
RU, TJ, TM), AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, C
A, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM
, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH,
GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, K
E, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS
, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN,
MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, S
D, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR
, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA,
ZW